

RFMD 新聞稿

公司聯繫：

RF Micro Devices Inc.  
Ben Thomas, Director, Corporate  
Relations  
7628 Thorndike Road  
Greensboro, NC 27409-9421, USA  
Tel: +1 +1.336.678.7337  
[bthomas@rfmd.com](mailto:bthomas@rfmd.com)



## RFMD<sup>®</sup>針對 3G 多頻、多模行動裝置 發表 WCDMA/HSPA 功率放大器模組系列

*RF720x 產品系列最佳化，以配合業界領導開放市場 3G 晶片組供應商之參考設計*

西班牙巴塞隆納— 2009 年 2 月 17 日—設計及製造高效能半導體零組件之全球領導者 RF Micro Devices, Inc. (Nasdaq GS: RFMD) 今日發表 RF720x 系列之 WCDMA/HSPA<sup>+</sup> 功率放大器 (PA)。RFMD 的 RF720x 產品系列包括四個功率放大器，其專門針對 3G 多模裝置而設計，以建置特定模式、特定頻段前端架構。RF720x 產品系列包涵所有主要的 WCDMA/HSPA<sup>+</sup> 頻段和頻段組合，並為了配合業界領導開放市場 3G 晶片組供應商之參考設計而最佳化。

RFMD 零組件解決方案事業單位總經理 Paul Augustine 表示：「RF720x 大幅提升 RFMD 的能力，以擴展我們在 3G 的領導性，同時透過提供與領導性開放市場 3G 晶片組供應商的相容性參考設計而延伸客戶的觸角，尤其是在韓國、中國和台灣。我們預期在 2009 年在 3G 市場將持續擁有兩位數的成長，並且我們也從在此成長市場所進行之有利設計專案而獲得鼓舞。」

RF7200 (頻段 1)，RF7206 (頻段 2)，RF7203 (頻段 3, 4, 9 或 10) 和 RF7211 (頻段 11) 是針對單一頻段操作而設計，而 RF7201 (頻段 1/8)，RF7202 (頻段 2/5) 和 RF7205 (頻段 1/5) 則於單一模組封裝內建二個特定頻段 PA。RF720x 產品系列中，每個放大頻段均具備一組特定頻段高效率、線性功率放大器，其專門設計以隨著輸出功率位準的降低而減少電流損耗。低功耗效率的提升，可透過使用三個數位電源模式達成，其能調整偏置電流，並針對想要的輸出功率範圍最佳化 PA，同時維持線性度。

RF720x 產品系列的每個 PA 都包括一內建的輸出功率耦合器，其能去除晶片組監測和調整 PA 輸出功率時對外部耦合器的需求。內建的電源耦合器可大幅縮減前端建置所要求的板面空間，並降低行動裝置之物料成本 (BOM)。RF7201 和 RF7202 均可進一步縮小板面空間，並透過在一模組中結合最高量能 WCDMA/HSPA<sup>+</sup> 3G 頻段組合，使建置更為順暢。透過從 RF720x 系列結合多個 PA，手機製造者和平台提供者將能相容主要的 WCDMA/HSPA<sup>+</sup> 頻段組合，包括頻段 1/8，頻段 1/5，頻段 2/5，頻段 1/2/5 和頻段 1/3/8。

## 領導業界的 3G PA 技術

RFMD 的寬廣 3G 前端產品陣容，具備創新產品和產品系列，能相容於所有主要 3G RF 架構，包括既有的特定模式/特定頻段及特定模式/多頻架構，與新興的多模/多頻“統合式”架構。

RFMD 的特定模式/特定頻段產品，如 RF720x 產品系列，提供低成本的單頻 3G 建置及多頻 3G 應用的設計彈性。RFMD 的特定模式/多頻產品，統合 RFMD 經驗證的正交(或“平衡”) PA 技術，並包含 RF6280 3G 傳輸系統與 RF9372 (單一路徑)，RF3278 (雙路徑)和 RF6278 (三路徑)寬頻 PA。RFMD 的正交 PA 強化了多頻平台能力，並提升對 VSWR (“天線不匹配”)的免疫性。

RFMD 的革命性多模/多頻統合性產品包括近期發表的 RF6460 前端平台，其運用 RFMD 的高量能正交 PA 技術，以從單一、可升級的前端平台提供業界最廣的頻段覆蓋率(頻段 1-6, 8-10)。RFMD 的統合性前端平台能針對多頻智慧型手機 (和其他行動裝置，例如數據卡)達到最小尺寸及最低成本建置，同時可支援所有空中介面標準 — GSM/GPRS、EDGE、CDMA、TD-SCDMA (3G)，WCDMA/HSPA+ (3G)和 LTE 的(4G)。

RF720x 系列之技術特性包括：

- 精小、扁平的封裝：單頻 – 3 x 3 x 1 mm, 雙頻 – 4 x 5 x 1 mm
- 絕佳的低功耗效率
- 3 個功率模式狀態，具備特定晶片組數位控制介面
- 內建電壓穩壓器 (Vreg)
- 內建輸出功率耦合器
- 高度整合的模組，不需外部阻斷或去耦電容

## 供貨與定價

RF720x 系列的樣品及量產前量購可立即供貨。如需更多價格資訊，請與您當地的 RFMD 業務代表聯繫，或參閱 [www.rfmd.com/purchase](http://www.rfmd.com/purchase)。根據近期的設計專案，RFMD 預計 RF720x PA 將於 2009 年第四季度開始出貨。

## 關於 RFMD:

RF Micro Devices, Inc. (NASDAQ GS: RFMD)是設計及製造高效能半導體元件之全球領導者。RFMD 的產品致能了全球的無線應用，為蜂巢式手機、無線基礎設施、無線區域網路 (WLAN)、CATV/寬頻及航太與國防應用提供強化的連結性。RFMD 在半導體技術的多元化產品及 RF 系統專長廣受肯定，並且是全球領導行動裝置、及通訊裝置供應商之優先廠商。

RFMD 總部設於北卡羅萊納州 Greensboro，該公司已獲得 ISO 9001- 及 ISO 14001-認證，並擁有全球化的工程、設計、業務及服務據點。RFMD 於納斯達克全球精選市場以 RFMD 之代碼上市，如需進一步資訊，請參閱 RFMD 網站 [www.rfmd.com](http://www.rfmd.com)

本新聞稿所包含“前瞻性聲明”，乃根據 1995 年「私人安全訴訟改革法案 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」中的「免責規定 (safe harbor)」所為。本文中的前瞻性聲明包括，但不限於關於本公司所擬計畫、目標、陳述及主張之聲明，其非歷史事實，典型以使用諸如：“也許”“將”“應該”“可能”“期望”“計畫”“預測”“相信”“預估”“預測”“潛力”“持續”及相似文字以界定。請注意此前瞻性聲明包含

此間所效能管理者目前的判斷及期望，但我們的實際結果、事件及績效將可能與此前瞻性聲明之表達及暗示具有實質性的差異。我們並不會更新這些前瞻性聲明、或公開發表這些前瞻性聲明的修正結果，除非為聯邦證券法規(federal securities laws)之要求下。RF Micro Devices 的業務受多種風險及不確定性因素的影響，包括季度運營結果的易變性；無線市場的成長與發展速率；與以下方面相關的風險：排除於我們無線系統業務之計畫，包括蜂巢式收發器及 GPS 解決方案，調整變更之風險可能高於原有預期，以及成本的節省、以及無法達到的調整利益。以及下列風險：晶圓製造、分子束外延與測試，裝配及測試、tape，捲線裝置。我們完成併購及統合所併購公司之能力，包括我們對來自業務整併的預期協同性的未知。我們以及吸引及保留熟練員工及培養領導者的能力，生產良率的易變性，採用新技術以降低成本、提高毛利率的能力，將新產品推向市場的能力；快速增加產能以適應產品需求增長的能力；對有限客戶的依賴，以及對第三方的依賴。在由美國證券協議委員會歸檔的 RF Micro Devices 10-K 報表的最新年度報告中，更詳細討論的這些以及其他風險及不確定性因素，可能導致實際結果及發展與此處任何一個前瞻性聲明中明示或暗示的意義存在本質性偏差。

RF MICRO DEVICES® 及 RFMD® 為 RFMD, LLC 商標。所有其他公司名、商標及註冊商標為其個別擁有者所持有。